



关于东莞优邦材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
申请文件的第三轮审核问询函的回复

保荐人（主承销商）



申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

二〇二六年七月

深圳证券交易所：

贵所《关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函》（审核函〔2026〕010087号，以下简称“《问询函》”）收悉。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为东莞优邦材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“优邦科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，已会同发行人、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）、国浩律师（广州）事务所（以下简称“发行人律师”），就需要发行人及各相关中介机构做出书面说明和核查的有关问题逐项落实，并对招股说明书等申请文件进行了相应的修改、补充完善。现将问询函回复如下，请予审核。

说明：

1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“招股说明书”）一致。

2、本问询函回复中的字体代表以下含义：

问询函所列问题	黑体（加粗）
对问题的回复	宋体
对招股说明书等文件的修改、补充	楷体（加粗）

3、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

1、关于创新性和市场竞争.....	3
-------------------	---

1、关于创新性和市场竞争

申报材料及问询回复显示：

当前电子装联材料中高端市场由国际厂商占据主导地位，国内下游产业链对供应链安全及本土化配套需求提升，国产替代趋势持续深化。发行人主要产品聚焦于智能终端、通信、新能源、半导体等领域。

请发行人披露：

（1）区分电子胶粘剂、电子焊接材料等产品类型，列示发行人产品在不同应用领域、终端分布情况，具体应用环节、发行人产品是否为对应环节的必备产品，说明发行人业务向 AI 服务器、半导体封装等领域延伸的最新进展。

（2）结合发行人与主要客户从配套开发至获取订单的完整业务流程、下游 EMS 厂商供应商准入标准及转换成本、发行人在主要厂商供应份额变动情况等，说明发行人与客户合作稳定性的具体体现，是否存在供应份额下降、大客户流失的风险，并完善相关风险揭示。

（3）结合上述事项的回复，以及发行人在各主要领域市场份额变动、产品技术先进性的具体体现等，说明发行人核心产品的技术含量、与竞争对手是否存在明显技术差距、是否具备创新性和成长性。

请保荐人简要概括核查过程，并发表明确核查意见。

【回复】

一、发行人披露

（一）区分电子胶粘剂、电子焊接材料等产品类型，列示发行人产品在不同应用领域、终端分布情况，具体应用环节、发行人产品是否为对应环节的必备产品，说明发行人业务向 AI 服务器、半导体封装等领域延伸的最新进展

1、区分电子胶粘剂、电子焊接材料等产品类型，列示发行人产品在不同应用领域、终端分布情况，具体应用环节、发行人产品是否为对应环节的必备产品

（1）主营业务收入分布情况

报告期内，发行人主营业务收入保持持续增长，业务结构整体呈现“基本盘稳固、增长极凸显、前瞻点蓄力”的积极态势。结合收入在不同应用领域和终端的分布情况来看，消费电子系发行人稳固基本盘的主体业务，其中 A 公司和 D 公司产业链贡献消费电子领域 50%左右销售收入，能够深度切入并稳定服务于对产品技术要求极高的全球顶尖科技品牌，充分印证了发行人产品的高技术壁垒与核心价值；AI 服务器系发行人当前业绩增长的重要来源，报告期内服务器领域销售收入分别为 9,062.78 万元、12,003.09 万元、18,053.42 万元，期间年复合增长率高达 41.14%，最近一两年发行人在服务器领域销售的产品，基本系应用于 AI 服务器领域，发行人紧抓 AI 算力市场爆发机遇，一方面通过深度配套富士康、奇宏科技、台达集团等切入英伟达、谷歌、亚马逊等国际巨头产业链，另一方面产品成功通过阿里云、D 公司、新华三等国内头部厂商的严苛测试并实现供货，为收入实现快速增长奠定坚实基础；半导体系发行人攻坚高精尖技术的战略业务，报告期内半导体领域销售收入分别为 434.57 万元、496.96 万元、1,100.77 万元，尽管当前收入规模仍较小，但随着多款先进封装材料通过星科金朋、华天科技、长电科技、甬矽电子等国内主流封测厂商测试、验证和小批量供货，预计半导体领域将成为驱动发行人未来高质量发展的核心潜在增长点。

报告期内，发行人主营业务收入在不同应用领域和终端分布情况如下：

单位：万元

项目	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
消费电子	57,630.09	51.24%	58,837.06	57.88%	52,451.81	59.15%
服务器	18,053.42	16.05%	12,003.09	11.81%	9,062.78	10.22%
工业控制	12,409.98	11.03%	12,327.48	12.13%	12,042.69	13.58%
汽车电子	8,223.91	7.31%	8,074.17	7.94%	7,313.88	8.25%
新能源及储能	9,304.95	8.27%	4,604.19	4.53%	2,560.84	2.89%
半导体	1,100.77	0.98%	496.96	0.49%	434.57	0.49%
其他	5,743.98	5.11%	5,314.10	5.23%	4,810.31	5.42%
合计	112,467.10	100.00%	101,657.05	100.00%	88,676.88	100.00%

注：工业控制领域终端产品主要包括电动工具、工业电源、安防设备等，下同。

（2）细分产品收入分布情况

①电子胶粘剂

发行人电子胶粘剂收入主要分布于消费电子、服务器等应用领域，并已形成以国际、国内知名终端品牌供应链客户为核心的业务布局。发行人积极向 AI 服务器、半导体封装等新兴应用领域拓展，产品应用场景持续丰富。

报告期内，发行人电子胶粘剂收入分布情况如下：

单位：万元

项目	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
消费电子	7,867.04	29.95%	7,933.08	33.05%	7,923.04	32.94%
服务器	4,065.87	15.48%	3,309.45	13.79%	3,760.68	15.63%
工业控制	3,956.93	15.06%	4,750.38	19.79%	4,625.86	19.23%
汽车电子	3,312.27	12.61%	4,093.71	17.05%	4,715.28	19.60%
新能源及储能	6,002.31	22.85%	2,288.93	9.54%	1,029.54	4.28%
半导体	8.40	0.03%	15.11	0.06%	18.76	0.08%
其他	1,054.17	4.01%	1,613.34	6.72%	1,983.08	8.24%
合计	26,266.99	100.00%	24,003.99	100.00%	24,056.25	100.00%

发行人电子胶粘剂具体应用于不同领域相关产品/模组/部件/工艺所需的粘接、导热、灌封等环节，均为对应环节的必备产品。

②电子焊接材料

发行人电子焊接材料收入主要分布于消费电子、服务器等应用领域，随着 AI 服务器市场快速发展，发行人在服务器领域收入占比持续提升，成为发行人电子焊接材料业务的重要增长方向。

报告期内，发行人电子焊接材料收入分布情况如下：

单位：万元

项目	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
消费电子	24,930.36	43.19%	20,246.55	46.24%	17,312.98	49.85%
服务器	13,026.32	22.57%	7,946.72	18.15%	4,817.25	13.87%

项目	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工业控制	8,135.95	14.10%	7,332.67	16.75%	7,063.50	20.34%
汽车电子	4,051.16	7.02%	2,734.01	6.24%	1,974.79	5.69%
新能源及储能	3,277.98	5.68%	2,303.93	5.26%	1,523.44	4.39%
半导体	472.72	0.82%	171.07	0.39%	105.01	0.30%
其他	3,825.13	6.63%	3,054.69	6.98%	1,932.43	5.56%
合计	57,719.62	100.00%	43,789.63	100.00%	34,729.40	100.00%

发行人电子焊接材料具体应用于不同领域相关产品/模组/部件/工艺所需的焊接等环节，均为对应环节的必备产品。

③湿化学品

发行人湿化学品收入目前主要来源于消费电子领域，并持续向服务器、半导体等高端制造领域拓展。发行人持续推进高端客户导入和产品验证，为未来业务持续增长培育新的增长点。

报告期内，发行人湿化学品收入分布情况如下：

单位：万元

项目	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
消费电子	13,880.99	87.64%	22,307.88	93.69%	21,994.01	94.50%
服务器	908.87	5.74%	746.87	3.14%	484.84	2.08%
工业控制	286.01	1.81%	241.39	1.01%	353.33	1.52%
半导体	488.46	3.08%	309.34	1.30%	231.97	1.00%
其他	274.83	1.74%	205.71	0.86%	210.05	0.90%
合计	15,839.15	100.00%	23,811.19	100.00%	23,274.20	100.00%

发行人湿化学品具体应用于不同领域相关产品/模组/部件/工艺所需的表面处理、清洗等环节，均为对应环节的必备产品。

④自动化设备

发行人自动化设备收入主要来源于消费电子领域。发行人坚持自动化设备业务与电子装联材料业务协同发展，通过材料、工艺与设备一体化配套提升客户服

务能力，有助于增强客户合作黏性和提升发行人综合竞争能力。

报告期内，发行人自动化设备收入分布情况如下：

单位：万元

项目	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
消费电子	10,951.70	86.63%	8,349.55	83.06%	5,221.78	78.91%
服务器	52.35	0.41%	0.05	0.00%	-	-
汽车电子	613.03	4.85%	1,078.56	10.73%	504.26	7.62%
半导体	131.20	1.04%	1.44	0.01%	78.83	1.19%
其他	893.05	7.06%	622.64	6.19%	812.16	12.27%
合计	12,641.34	100.00%	10,052.24	100.00%	6,617.03	100.00%

发行人自动化设备具体应用于不同领域相关产品/模组/部件/工艺所需的点胶、检测等环节，均为对应环节的必备产品。

2、说明发行人业务向 AI 服务器、半导体封装等领域延伸的最新进展

AI 服务器属于算力产业高速扩张的新兴赛道。报告期内，随着人工智能产业在全球爆发式增长，算力需求的结构化升级带动 AI 服务器需求大幅增长，最近一两年发行人在服务器领域销售的产品，基本系应用于 AI 服务器领域。相较普通服务器，AI 服务器面临极限高热容、极宽工艺窗口与高局部温差挑战，同时需在 85°C-105°C 极限高温、7×24 小时满载下服役 10-15 年，对电子装联材料高效散热、严苛条件下长期服役稳定性均提出更高挑战。

项目	AI 服务器	普通服务器
PCB 层数	24-32 层以上	12-16 层
PCB 厚度	3.0mm-4.5mm	1.6mm-2.4mm
PCB 热容属性	极限高热容	中等热容
服役温度	85°C~105°C，极限持续高温	70°C~85°C，高温
铜箔密度	全板高密度大面积连续铺铜	局部大铺铜
核心芯片尺寸	超大尺寸，70mm*70mm-200mm*200mm	尺寸中等，通常最大 50mm*50mm
PCB 高低反温差ΔT	≥35°C-40°C，升温温差极大	15°C-25°C，升温温差中等
服役运行生命周期	10-15 年	5-8 年

发行人针对大尺寸芯片装联、持续极限高温与高 ΔT 、长期服役稳定等技术难点，率先研发出用于 AI 服务器内部封装的高可靠锡膏产品，已实现对国内头部厂商阿里云交付，并通过 D 公司产品测试。发行人用于 AI 服务器散热模组的低温锡膏产品已大批量交付国际知名散热模组厂商奇宏科技，最终应用于英伟达、谷歌、亚马逊等国际巨头产品。目前，发行人在 AI 服务器领域已具备一定销售规模，且相关产品正逐步通过国内、国外知名终端品牌的认可和交付，预计在 AI 服务器领域销售收入将随着下游市场扩张继续保持增长，是发行人销售收入实现增长的关键领域。

半导体封装是芯片产业高端化升级的核心环节，且在先进封装领域存在“卡脖子”问题，目前国产替代尚处于发展初期，国内电子装联材料市场仍以日本信越、美国陶氏、日本千住、美国钢泰、美国爱法、德国 ZESTRON、美国 KYZEN 等国际厂商为主导，仅具备核心技术优势的国内头部企业有能力进行半导体封装领域电子装联材料的研发。半导体封装领域电子装联材料用量较少，市场规模相对较小，但产品技术难度大、技术壁垒高，高可靠粘接焊接、长期服役可靠、超低间隙清洗等场景对配套电子装联材料提出更高要求，发行人已率先实现 TIM 导热、半导体封装用水溶性锡膏及助焊剂、超低间隙先进封装器件清洗、芯片级真空点胶技术突破，相关产品已通过星科金朋、华天科技、长电科技、甬矽电子等国内主流封测厂商测试，是发行人产品高技术含量的关键体现。

在 AI 服务器、半导体封装领域，发行人基于自身技术优势，精准匹配下游新兴高端制程的严苛性能要求，持续推进相关应用场景所需电子装联材料和自动化设备的研发、验证与批量交付，发行人已研发众多代表性产品，其中部分产品已实现批量交付，部分产品正在测试验证中。

（二）结合发行人与主要客户从配套开发至获取订单的完整业务流程、下游 EMS 厂商供应商准入标准及转换成本、发行人在主要厂商供应份额变动情况等，说明发行人与客户合作稳定性的具体体现，是否存在供应份额下降、大客户流失的风险，并完善相关风险揭示

1、发行人与主要客户从配套开发至获取订单的完整业务流程

发行人与主要客户从配套开发至获取订单，经过需求对接、产品开发、客户

认证、订单交付四个主要阶段，具体说明如下：

（1）需求对接。主要客户基于产品更新换代、供应链多元化布局、推进现有物料国产替代等需求，向发行人提出新项目开发需求，通常包括技术规格、应用目标等需求信息，发行人提出初步技术方案后，客户就技术方案进行讨论和评审，发行人据此完成项目立项，明确开发方向。部分客户特定项目，存在同时向发行人及其他合作供应商提出开发需求的情形。

（2）产品开发。发行人根据客户提出的具体应用场景与性能参数要求，进行针对性的配方设计与工艺开发。发行人内部产品开发需经过设计验证、制程验证、小批量试产等阶段，最终研制出符合客户需求的产品。

（3）客户认证。客户认证包括产品认证和供应商体系认证。发行人分阶段向客户送样，由客户进行性能及可靠性测试，在此过程中可能存在发行人产品不满足标准而未通过客户认证，或需要经过多轮开发测试的情形，对于部分客户向多家合作供应商同时提出开发需求的特定项目，亦可能存在发行人产品不及竞争对手的情形，属于行业正常现象，发行人持续进行产品研发改进。发行人需取得下游客户认证，部分产品还需取得终端品牌的双重认证，相关认证标准严苛、周期较长，通常需半年至一年，半导体等高端领域客户认证周期可达 3-4 年。

（4）订单交付。发行人通常先承接客户的小批量试产订单，在经过上机试制、验证良率并排除批量质量风险后，方进入稳定批量供货阶段。产品销售价格主要依据议价或竞标结果确定。

通过长期的业务合作，发行人与主要客户关系不断加深。发行人持续服务国内外一线客户，通过深度参与客户前沿项目进行合作开发，使得发行人能够在客户相关产品供应上占据先发优势，有利于保障发行人与客户合作的稳定性。发行人与部分主要客户的合作情况说明如下：

（1）富士康

发行人与富士康自 2008 年开展合作至今，合作业务已覆盖发行人四大业务板块。富士康作为全球最大的 EMS 厂商，其消费电子精密加工制程对配套材料提出定制化、高可靠性的严苛要求，市场通用标准化产品难以满足部分复杂加工

场景，尤其对湿化学品的专用化解决方案需求突出。发行人产品性能与工艺符合富士康需求，与富士康开展 3C 结构件加工全流程湿化学品战略合作，涉及产品包括清洗剂、切削液、切削油、抛光液、保护油墨等。发行人持续投入研发和开发富士康所需产品，双方战略合作关系加深。

发行人持续参与富士康产品定制开发，对富士康产品需求的技术路径、规格参数、开发成本等均有深度了解，使得发行人在富士康相关项目竞争中率先建立技术优势和信息优势等，亦保障了与富士康未来合作的稳定性。

（2）台达集团

发行人与台达集团自 2009 年开展合作至今，合作业务覆盖电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品业务板块。台达集团业务覆盖电源管理、散热管理、数据中心基础设施、新能源汽车等领域，是全球电源及能源管理领域的重要厂商。其产品广泛应用于服务器、工业自动化、汽车电子、数据中心等场景。

台达集团对电子装联材料实行严格准入管理，要求供应商具备完善质量、环保资质，且物性、可靠性、批次一致性需满足高可靠要求，整体导入门槛高、验证周期长。而发行人较早即与台达集团建立合作关系，深度参与台达集团新品前期材料验证，因此发行人新品导入优势明显。产品导入后，发行人供给的装联材料与客户工艺深度绑定，胶料固化参数、点胶工艺与客户产线高度适配，换材易导致良率下降，台达集团替换供应商成本高，替换意愿低，使得发行人在台达集团相关项目竞争中占据先发优势，亦保障了与台达集团未来合作的稳定性。

（3）奇宏科技

发行人与奇宏科技自 2011 年开展合作至今，双方合作主要围绕散热模组及相关电子装联应用展开。奇宏科技在散热模组、服务器散热、消费电子散热等领域具有较强市场地位，其产品广泛应用于高性能计算、AI 服务器、显卡、通信设备及消费电子等场景。随着 AI 服务器功耗和算力密度持续提升，散热模组的结构复杂度、材料可靠性和制程精度要求不断提高，对配套锡膏等电子装联材料提出了更高要求。

奇宏科技下游客户多为国际巨头厂商，所处产业链具有客户认证严格、产品

导入周期较长的特点。发行人较早即与奇宏科技建立合作关系，形成并保持了长达 15 年的深度战略合作，在对奇宏科技新产品导入中占据先发优势，并得以通过奇宏科技切入英伟达、谷歌、亚马逊等国际巨头供应链。而奇宏科技出于供应链安全与生产稳定性考量，优先选择已合作供应商和已导入产品，亦有利于保障发行人与奇宏科技未来合作的稳定性。

2、下游 EMS 厂商供应商准入标准及转换成本

(1) 准入标准

发行人下游客户包括大型 EMS 厂商、部件和模组专业制造厂商等，因电子装联材料的性能表现直接影响终端产品的最终可靠性，为了防范极高的潜在客诉与召回风险，下游客户建立了严苛、冗长的供应商准入与材料验证体系。

①采用多维度评价体系，要求供应商综合实力突出

下游客户对供应商的产品质量、价格、交付、服务等进行综合考量，要求供应商综合实力突出。由于电子装联材料性能表现直接影响终端产品，且部分材料服役环境严苛，下游客户通常会要求在一定周期内进行多次小批量试产验证，以充分验证供应商产品的可靠性、功能性、苛刻环境耐受性，使得产品质量考核标准较高，周期较长。同时，下游客户在新需求响应速度、新产品研发速度、稳定批量交付等方面对供应商进行综合考量，以评价供应商的整体实力。

②品牌和厂商双重认证，导致供应商认证门槛较高

发行人产品最终应用于国内外知名终端品牌产品，终端品牌基于产品质量和供应链管控目的，对代工厂的供应商选择通常具有较强话语权。发行人下游客户在选择合作供应商时，通常会要求供应商需取得终端品牌认证，而终端品牌认证具有标准严苛、周期冗长的特点，导致整体认证门槛较高。

③基于客户定制化需求，要求供应商提供深度服务

由于终端品牌产品多样、迭代速度快，且不同产品对电子装联材料的定制化需求显著，供应商为保持产品适配性，需深度参与下游客户的项目开发过程。下游客户重点考核供应商深度服务的能力、意愿，项目合作不再限于产品本身，而

是要求供应商在技术路径上服务于下游客户的产品战略，同时在研发资源投入上达到一定标准，在企业管理体系、团队人员建设等方面达到更高要求。

（2）转换成本

发行人下游客户对供应商的转换成本较高，通常经过长周期的产品开发、认证，下游客户一旦确认供应商产品性能达标并定型入库，通常会与供应商形成极强黏性的长期滚动合作机制，不会轻易更换。

①供应商认证门槛高，导致新进入者难度大、所需时间长

下游客户和终端品牌对供应商建立了高认证门槛，在有利于已进入供应商合作稳定性的同时，导致新进入者难度大、所需时间长，其本身也导致下游客户无法在短时间内、轻易更换供应商。

②更换供应商需重新验证，导致高额的测试、产线调试成本

供应商产品通常需在客户实际应用场景进行多批次实验验证，对于高端应用领域客户，其产线及产品价值高昂，若更换供应商需重新验证，客户需承担高额的测试、产线调试成本。

③更换供应商影响终端产品的可靠性，导致潜在客诉与召回损失

电子装联材料的性能表现直接影响终端产品的最终可靠性，下游客户若更换供应商，需承担电子装联材料因产品性能和可靠性验证不足，最终影响终端产品表现和质量的风险，可能导致极高的潜在客诉与召回损失。

④长期共同开发强化客户粘性，更换供应商导致承担高额时间成本等

电子装联材料产品定制化需求显著，长期共同开发使得客户与供应商合作粘性不断强化，若更换供应商意味着需重新经过长时间的合作磨合，叠加品牌和厂商的双重认证门槛，导致更换供应商需承担高额的时间成本和其他隐形成本。

3、发行人在主要厂商供应份额变动情况

报告期内，发行人主要客户包括富士康、D 公司、奇宏科技、台达集团、群光电能、明纬电子等。发行人与主要客户普遍已有较长合作历史，且整体合作关

系稳定，不存在对主要客户供应份额或产品竞争力明显下降的情形。

同时，随着人工智能技术快速发展，以及大模型训练需求持续增长，云计算厂商及互联网企业加大了对 AI 服务器的采购及部署力度。AI 服务器普遍搭载高功耗 GPU、AI 加速芯片及高速互联组件，单台服务器整体功耗及芯片热密度较传统服务器大幅提升。奇宏科技作为全球知名的 AI 服务器散热模组厂商，其受益于下游 AI 服务器市场需求快速增长，散热模组订单增加，对发行人电子焊接材料采购增加，发行人在奇宏科技供应份额有所增加。

4、说明发行人与客户合作稳定性的具体体现

发行人与客户合作稳定性体现在以下方面：

（1）主要客户准入门槛高，转换成本较高

电子装联材料企业进入下游客户合格供应商体系前，通常需要经过严格的资质审核、产品认证、小批量试用、产线导入验证等多个环节，验证周期较长，涉及客户研发、品质、采购等多部门评审。一旦完成认证导入，若更换供应商，客户需重新投入认证成本、时间成本，并承担新材料导入可能带来的质量风险，因此客户更换供应商的转换成本较高，进一步强化了现有合作关系的稳定性。

（2）主要客户合作历史长，交易稳定持续

发行人自设立以来始终深耕电子装联材料行业，与主要客户平均合作时长超过十年。在合作期间，发行人向主要客户的交易份额呈现稳步增长趋势，未出现异常波动或骤降情形，体现了发行人与主要客户合作关系的持续性与稳定性，亦反映了发行人产品质量及服务水平获得客户的持续认可。

（3）共同开发带来技术优势，增强客户粘性

因电子装联材料产品定制化需求显著，与一线终端品牌客户及其供应链的长期共同开发，帮助发行人持续跟踪行业前沿技术，保障产品与技术始终处于行业先进水平。同时，长期共同开发使得客户与供应商合作粘性不断强化，若更换供应商意味着需重新经过长时间的合作磨合。

5、是否存在供应份额下降、大客户流失的风险，并完善相关风险揭示

报告期内，发行人与主要客户合作关系稳定，且销售情况良好，不存在对主要客户供应份额或产品竞争力明显下降的情形，发行人供应份额下降、大客户流失的风险较小。发行人已在招股说明书“第三节 风险因素”之“一、与发行人相关的风险”之“（一）经营风险”补充进行风险提示，具体如下：

“7、大客户流失、供应份额下降的风险

公司产品广泛应用于智能终端、通信、新能源、半导体等产业领域，公司所处行业产品技术升级和更新迭代速度较快，需要持续研发符合客户需求的新产品，并与竞争对手展开技术竞争，公司在研发创新能力、响应速度、现有储备技术与行业新需求的匹配性等方面将受到诸多挑战。

报告期内，公司与主要客户合作关系稳定，不存在对主要客户供应份额或产品竞争力明显下降的情形。但如果未来公司在研发创新能力、响应速度、产品质量、交付效率等方面无法持续满足客户要求，将面临重要客户流失、供应份额下降的风险，进而对公司经营业绩的持续性和稳定性产生不利影响。”

（三）结合上述事项的回复，以及发行人在各主要领域市场份额变动、产品技术先进性的具体体现等，说明发行人核心产品的技术含量、与竞争对手是否存在明显技术差距、是否具备创新性和成长性

1、发行人在各主要领域市场份额变动

（1）消费电子：深度服务头部品牌供应链，市场份额整体保持稳定

消费电子是发行人优势应用领域。报告期内，发行人持续深度服务 A 公司和 D 公司等国内外消费电子头部品牌供应链，产品销售与终端客户新品发布节奏、出货量变化、产品结构升级、供应链份额调整等密切相关。近年来，全球消费电子市场在经历前期库存调整和需求放缓后，已逐步恢复稳定并有所增长。

发行人已进入 A 公司和 D 公司等头部品牌客户供应链，具备较好的客户基础和持续服务能力，消费电子业务和市场份额整体保持稳定。未来，随着 A 公司和 D 公司等头部品牌客户继续推进终端产品迭代，以及 AI 手机、智能穿戴、汽车与消费电子融合等新应用场景逐步发展，发行人在消费电子领域销售收入有望保持较为稳定的增长，市场份额有望实现稳中有升。

（2）AI 服务器：产业链处于高景气扩张阶段，市场份额有望得到提高

AI 服务器是发行人收入增长较快的新兴应用领域。随着大模型训练、推理应用、云计算平台扩容、数据中心算力基础设施建设等持续推进，AI 服务器对高性能、高可靠性的电子装联材料、导热材料及相关工艺配套提出更高要求。与传统服务器相比，AI 服务器通常具有更高算力密度、更高功耗、更复杂的板级连接和散热需求，对材料可靠性、稳定性和批量交付能力要求更高，因此相关供应链一旦完成导入，后续随客户项目放量具备较强延展性。

AI 服务器仍处于快速扩张阶段，下游云厂商、互联网企业、通信设备厂商及算力基础设施企业持续加大资本投入，相关产业链景气度预计仍将维持较高水平。发行人应用于 AI 服务器的低温锡膏产品已批量交付奇宏科技，进入规模化销售阶段，预计将随着奇宏科技销售规模增长而增长，同时发行人不断拓展新的下游客户，相关低温锡膏产品已交付讯强电子（隶属于 Cooler Master 集团，同为全球知名散热模组厂商），新客户拓展亦将带动发行人销售规模增长。与此同时，随着 AI 服务器芯片尺寸的不断增大，为了解决大芯片翘曲问题，需降低焊接温度以保证组装良率，中温锡膏的应用将成为行业发展必然趋势，发行人基于锡粉自产及合金配方技术，在国内率先开发出多维冶金混合中温锡膏等产品，目前应用于 AI 服务器的中温锡膏产品已通过新华三、阿里云的可靠性测试，并已向 D 公司、中兴通讯送样测试中。在电子胶粘剂、清洗剂、自动化设备方面，发行人应用于 AI 服务器的导热结构胶、环保水基清洗剂、自动化点胶设备等已进入 D 公司、富士康、阿里云等客户供应体系，并实现小批量交付。

综上，未来随着 AI 服务器出货规模扩大、客户项目持续放量、新产品和新客户持续扩展，发行人在 AI 服务器领域的产品销售规模有望继续增长，市场份额有望得到提高。

（3）半导体：产业链国产替代尚处初期阶段，市场份额有望稳步提高

半导体是发行人重点拓展的战略领域，相关产品主要应用于先进封装、芯片周边材料及高可靠电子装联场景。国内半导体产业链正处于自主可控和国产替代持续推进阶段，先进封装、汽车电子、AI 芯片等方向均对本土材料供应能力提出更高要求。特别是在先进封装、高性能计算和功率半导体等应用场景中，电子

装联材料需要满足更高可靠性、更高精度和更复杂工况要求，推动相关材料向高端化、精细化方向发展。

发行人半导体领域销售受下游客户认证周期、项目量产节奏、国产替代进程影响。由于半导体产业链对材料供应商的认证要求较高，产品导入周期较长，销售放量需经历样品验证、小批量试用到批量供应的渐进过程。发行人当前在半导体领域收入规模仍较小，但随着多款先进封装材料通过星科金朋、华天科技、长电科技、甬矽电子等国内主流封测厂商测试、验证和小批量供货，后续合作稳定性和成长空间保障性高，未来随着国产替代持续深化、先进封装和高端电子装联需求提升，发行人在半导体领域的市场份额有望稳步提高。

2、发行人产品技术先进性的具体体现、核心产品的技术含量

发行人产品技术先进性的核心体现，在于掌握了关键原材料的自主设计合成能力，并据此实现产品配方与性能的精准调控。

（1）关键原材料自主设计合成

①自主设计合成原材料是打破国外技术垄断、实现产品性能突破的基础

发行人下游客户主要为国内外电子制造行业龙头企业，对配套电子装联材料的性能指标提出远高于行业常规通用产品的严苛标准；同时，下游客户持续推进终端产品迭代与新型产品研发，进一步对适配前沿制造场景的电子装联材料提出更高的定制化、精细化性能要求，发行人开发产品需要紧跟国际先进水平。

当前国际厂商在满足下游客户高端制程要求的装联材料领域具备一定技术优势，发行人对标的国际巨头如美国陶氏、日本信越、美国迈图、美国钢泰、美国阿尔法、日本千住等企业均实现硅油、锡粉等核心原料自产，自主合成关键材料是高端电子材料行业头部企业的共识发展路径。

基于行业技术发展路径与下游高端客户国产化替代的迫切诉求，发行人坚定布局关键原材料自主合成，在国内供应商无法提供满足性能和品质原材料的情况下，创新性地设计和合成关键性原材料，以此突破国际厂商原材料技术垄断，摆脱高端特殊原材料对外采购依赖，实现底层工艺自主可控，在发行人擅长领域保持国内前沿水平，达到国际先进水平。

国内同行业可比公司基于自身战略定位与下游应用领域布局，形成差异化发展路径：回天新材聚焦光伏及工业用胶配套市场，德邦科技主要生产销售环氧及聚氨酯体系产品，与发行人有机硅体系应用的原材料存在差异，唯特偶锡条与锡丝营收占比较高。同行业可比公司均围绕自身产品体系及应用领域匹配相应的经营研发战略。发行人聚焦中高端领域电子装联材料的生产销售，利用自身在部分领域积累的技术优势，选择自主设计合成部分关键原材料。

②部分原材料国内无成熟供应渠道，自产原料支撑高端产品研发落地

目前针对高端产品，部分原材料国内供应商尚无法实现生产，不能满足客户要求，或虽然国内供应商有相关原材料，但不能满足项目的特殊性需求，同时国外供应商可能拒绝提供高端领域的原材料，无法保证相应产品研发落地。

原材料	产品名称	原材料自主合成优势
硅油	TIM1 高可靠性芯片封装硅凝胶	TIM1 胶用硅油原材料系定制原材料，国内供应商尚无定制生产能力，国外供应商具有生产能力，但拒绝提供相关原材料。原材料硅油的粘度，含氢量、离子含量等都对 TIM 胶的工艺性、固化力学性能、抗老化特性、批次稳定性有较高影响，超出范围的波动不满足客户对产品性能、可靠性、一致性的要求。在此背景下，发行人凭借在硅油合成领域的长期技术积累，实现特殊乙烯基硅油及含氢硅油自产，率先实现产品技术突破，加速实现国产替代。 发行人自产的乙烯基硅油可实现$\Sigma D3-10 < 100\text{ppm}$，离子含量$< 2\text{ppm}$，批次粘度波动$< 5\%$水平，自产特定含氢量的端含氢硅油和侧含氢硅油可实现$\Sigma D3-10 < 100\text{ppm}$，离子含量$< 5\text{ppm}$，含氢及分子量波动$< 5\%$水平，原材料的分子量稳定、乙烯基、氢含量根据项目需求设计和控制、超低$\Sigma D3-10$含量、离子含量保障 TIM1 产品的开发落地。
锡粉	多维冶金混合中温锡膏	此款中温锡膏核心合金体系之一的锡基中温合金用锡粉系定制原材料，国内供应商尚无定制生产能力，国外供应商具有生产能力，但拒绝提供相关原材料。发行人攻克锡基合金用锡粉自产难点，系国内率先实现多维冶金混合中温锡膏供应厂商，相关产品已通过阿里云服务器可靠性测试，并送样至 D 公司、中兴通讯检测中。

③缩短新品研发周期、率先实现技术突破

发行人围绕客户差异化需求开发新品时，依托原材料自主设计合成能力，能够更快实现原材料性能的最优匹配，缩短整体研发周期，率先实现新产品技术突

破和交付。行业发展过程中，虽逐步出现可供应同类原材料的外部厂商，但国内同行业竞争对手需经历需求提出、供应商筛选、供应商工艺开发等多轮周期，原材料交付与产品落地节奏慢。发行人自主合成模式可缩短研发周期，更快实现新品商业化导入。

原材料	产品名称	原材料自主合成优势
氧化铝填料	低热阻高导热高可靠性硅脂 UB-589	发行人开发适配索尼的低热阻高导热硅脂项目过程中，客户核心要求为热阻<0.07℃Ccm²/W，导热系数达到2.8W/m.k。发行人采用5μm球形氧化铝作为填料之一，最大粒径为60μm，经仿真测算，满足低热阻标准需控制最大粒径Dmax<12μm。 项目开发阶段，发行人对接国内十余家填料厂商均无法提供，日本厂商可供应达标填料，其采购单价为常规未分级填料的20倍，交付周期长达三个月。 发行人分阶段掌握关键填料分级技术，并形成填料Dmax精密测量能力。该项目把核心技术、核心设备、检测能力一并落地后，生产的产品完全达到客户要求，并大幅降低成本。依托该项目技术成果，发行人低热阻导热材料核心技术达到国际先进水准，率先实现对中兴通讯、D公司等客户的批量供货。
锡粉	耐热疲劳 HRA12合金、HRA092合金、LPS13合金、LPS839合金	发行人自产锡粉模式可缩短锡膏研发周期，更快实现新品商业化导入。发行人采取自产锡粉模式，其本质是由“材料应用型企业”向“底层机理研发型企业”的选择。锡膏作为电子装联功能材料，核心在于助焊剂活化机制与锡粉表面化学状态的绝对适配。外购不同供应商的锡粉无法保证提供这种微观的稳定适配。自产锡粉不仅保证了原材料的批次一致性，更是实现了合金配方研发周期的缩减。 目前，发行人锡粉生产优势包括：（1）可实现5-15μm锡粉（T6级别锡粉）、2-11μm锡粉（T7级别锡粉）生产；（2）微细锡粉一次收得率高，可实现T4级别锡粉53.7%、T5级别锡粉26.6%、T6级别锡粉12.4%的一次性收得率，优于行业常规水平；（3）整合气力分级技术、氮气循环技术和超声波筛分技术，解决传统锡粉制备过程中存在的球形度低、氧含量高、粒度分布宽等难题，Type4锡粉氧含量低于110ppm，Type5锡粉氧含量低于150ppm，优于行业常规数值。

④自主生产实现原材料品质长效稳定管控

原材料受不同供应商、不同生产批次影响，易出现原料性能差异。发行人自主合成能够有效实现关键原材料质量管控，如保证锡粉粒径分布中微粉段由标准

规定的<10%收窄至<5%、Type4 锡粉氧含量由行业通用的<140ppm 收窄至<110ppm 等，如发行人自产硅油可实现批次粘度波动<5%水平等，持续优化终端成品性能。整体来看，尽管国内同行业竞争对手也能从市场获取原材料，但是自主合成模式能够在原材料稳定性、产品需求适配度方面形成差异化优势。

(2) 产品配方与性能的精准调控

在原材料自主合成的基础上，发行人持续开展产品配方优化与生产工艺迭代升级，实现产品导热性能、低挥发性、阻燃性、固化效率、耐候性能、可靠性等关键指标的显著提升，在国内同类产品中具备突出的技术优势。

①产品单项性能指标优异，核心技术指标达到国内领先、对标国际水平

发行人产品性能突出，能够精准满足客户在导热性、低挥发性、阻燃性、耐候性、高焊接良率、高抗枝晶特性等方面需求。尤其是针对下游客户的特定应用场景，客户更加聚焦于产品的单项性能，并同时要求其余性能综合适配。发行人产品性能指标优异，核心技术指标达到国内领先、对标国际水平。

产品	性能指标	技术水平
低热阻高导热硅凝胶	最高导热系数达到 15W/m.K; 最低热阻低至 0.02℃.cm²/W	行业先进水平
脱醇型单组份 RTV 硅橡胶	低分子硅氧烷挥发性物质ΣD3-10 含量稳定控制在 100ppm 以下	国内领先，技术达到日本信越、美国陶氏水平
电源灌封胶	实现 1.5~3mm 阻燃 V0 级水平	国内厂商通过添加额外阻燃剂解决阻燃问题，发行人真正实现不添加阻燃剂或氢氧化铝等阻燃填料满足严苛阻燃需求。技术达到美国陶氏、日本信越水平
低温无铅锡膏	产品组装空洞率低，IPC<10%；锡膏焊后残留物具有高表面绝缘电阻，SIR 阻抗按 IPC 标准测试 1000 小时不失效；	行业普遍标准：IPC<25%；行业普遍标准：IPC 标准测试 168 小时不失效；国内领先，技术达到日本千住水平
高温无铅锡膏	实现枕头效应空焊 HnP 及不润湿空焊 NWO 不良发生率 0%	国内领先，技术达到日本千住水平
高抗枝晶可靠锡膏	实现 0.55±0.05 触变指数，在 0201 精密元器件体积转移率 Cpk>1.66,经测试 0.5mm 精密元件在 65℃、93%RH 高温高湿环境下加电工作 200 小时不短路漏电、不长枝晶	0.40-0.70 触变指数为行业常规适用区间，0.50-0.60 为高端精密焊接的理想区间；Cpk>1.33 代表工艺稳定水平，Cpk>1.66 代表工艺非常稳定、精度极高；国内领先，技术达到日本千住水平

②兼顾多维度性能均衡适配，多性能协同匹配具备较高技术门槛

通常情况下，大批量销售产品并非在单一性能上具有突出要求，但是需要产品在热稳定性、强度、固化条件、耐候、焊接温度、低焊接不良率、高表面绝缘特性等多重性能上实现平衡，综合适配客户需求，且其中部分属性天然冲突，需解决产品属性间平衡，发行人可以精准满足客户对产品的多重性能要求，即不追求极值的单一性能，多种性能的最佳适配同样具备极高的技术难度。

业务板块	技术壁垒	发行人产品举例
电子胶粘剂	实现导热、热稳定性、硬度、伸长率、耐候性、低挥发性、阻燃性、良好操作性等多性能匹配	脱醇型单组份室温硫化硅橡胶实现 Σ D3-10 含量稳定控制在 100ppm 以下，同时产品兼具较高活性与稳定性，产品无腐蚀、VOC 排放低，系国内先进技术，产品性能对标美国陶氏、日本信越
		环氧底部填充胶具有极低的热膨胀系数，实现 $CTE \leq 15ppm/^{\circ}C$ ，温度变化导致的产品形变水平极低；具有超低 α 射线释放特性以及极低的离子残留水平， α 粒子发射率 $\leq 0.01cph/cm^2$ ，显著提高芯片封装器件的可靠性和使用寿命；产品性能对标德国汉高、日本纳美仕
电子焊接材料	实现粘度、触变指数、印刷性、高表面绝缘性、组装良率等多性能匹配	基于焊料合金体系设计技术、低温无铅锡膏配方技术，成功实现 $175^{\circ}C$ 低温焊接，保障高效散热，有效避免芯片高温组装产生的空焊不良，同时焊点成型佳、耐候性强，提升客户产品使用寿命，产品性能对标日本千住
湿化学品	实现高清洗性能、环保（低 VOC 含量、低氮磷类化合物含量）、安全（低闪点）、低成本、对清洗基材无腐蚀等多重特性平衡	通过设计 PH 值为 6.5-8.0 的中性体系，大幅减弱对铜、铝、镍等金属的腐蚀驱动力，确保清洗过程处于安全范围。依托复配的非离子与阴离子表面活性剂的乳化、增溶、润湿作用，有效剥离油脂及松香类残留，在中性环境下实现高洁净度的精密化学清洗与控制，实现产品性能对标德国 ZESTRON
		在“中性”、“无氮”、“无磷”三重严格的化学约束下，半导体封装高效清洗难度增大。通过无机皂化反应物，减少封装清洗剂中氮元素的产生，采用多元嵌段聚醚类来替代含磷类活性剂，达到超低表面张力的效果，满足低离地间隙及窄植球间距上的残留清洗，达成清洗性能与环保属性的平衡，实现产品性能对标德国 ZESTRON

业务板块	技术壁垒	发行人产品举例
自动化设备	1、实现自动上料回流、视觉定位、微米级高精度点胶、自动测高与出胶量动态补偿、耐强腐蚀腔体结构、真空无尘密闭环境、在线外观检测等多项功能集成 2、设备定制化属性较强，需在较短开发周期内匹配不同客户差异化工艺规范与性能指标	摄像头五轴点胶机在 1.8m*1.8m 的空间中集成摄像头上料轨道，2 个上料机械手，8 个定位相机，2 个 3D 线激光扫描相机，2 套 0.01mg 精密电子天平，2 套点胶阀体。实现三维空间中高精度点胶，由 3D 线激光提供高度数据，根据产品高低起伏实时补偿。搭配定制开发软件算法处理多相机传回数据，低延时输出定位数据。整合 AOI 光学自动检测设备，通过 CIM 将检测结果传输至客户系统

3、与竞争对手是否存在明显技术差距

发行人聚焦于服务国内外头部品牌客户、EMS 制造厂商、专业模组制造厂商需求，针对美国陶氏、日本信越、日本千住、美国钢泰、德国 Zestron 等国际一流厂商形成垄断的中高端电子装联材料领域，持续进行技术研发与突破，以实现国产替代。因此，发行人在实际经营、技术研发、产品生产环节均直接与国际厂商产品进行对比。发行人优先筛选行业内具有代表性、技术水平领先的国外竞争对手，并选取应用于同类或相近客户群体的产品进行对比如下：

对标企业	对标产品	发行人产品	产品技术水平对比
日本信越	X23-7772-4	高可靠性芯片封装硅凝胶 UB-5723	均能实现 90min@125℃条件下固化，产品导热系数均为 3.5W/m.k，UB-5723 热阻为 0.10℃Ccm²/W，X23-7772-4 热阻为 0.092℃Ccm²/W，发行人产品水平与对标产品相当
美国陶氏	TC5888	低热阻高导热硅脂 UB588	TC5888 导热系数为 4.8W/m.k，UB588 导热系数为 5.2W/m.k，产品热阻均为 0.05℃Ccm²/W，BLT 均为 20μm，发行人产品水平与对标产品相当
日本松下	CV7803H	UV 固化环氧胶 UB-3083H	UB-3083H 固化深度>5mm，CV7803H 固化深度 3.5mm，产品玻璃化转变温度均为 130℃，热膨胀系数均为 25ppm/k，发行人产品固化深度优于对标产品

对标企业	对标产品	发行人产品	产品技术水平对比
日本千住	*	高抗枝晶可靠 锡膏 EUP- HRA12- NH5643	触变指数均为 0.55 ± 0.05 ，均可实现 0201 体积转移率 $Cpk>1.66$ ，0.5Pitch BTC 元件 $85^{\circ}\text{C}/85\%\text{RH}$ 条件下，测试电压 12.5V，发行人产品 8 个测试通道 200H 无失效发生，千住产品 8 个测试通道 200H 有 3 个通道发生失效，发行人产品残留抗枝晶生长优于对标产品
日本千住	L29-145HF	锡铋系低温锡膏 DW-1000HF	触变指数均为 0.55 ± 0.05 ，均可实现 0201 体积转移率 $Cpk>1.66$ ，0.5Pitch BTC 元件 $85^{\circ}\text{C}/85\%\text{RH}$ 条件下，测试电压 13.6V，DW-1000HF 测试 200 小时 8 个测试通道无失效发生，L29-145HF 测试 200 小时 8 个测试通道有 2 个通道发生失效，发行人产品残留抗枝晶生长优于对标产品
德国 ZESTRON	VIGON®N598	S-P109	VOC 值均 $<300\text{g/L}$ ，均可兼容金属铝及合金，S-P109 表面张力为 26.9mN/m ，且可兼容金属铜及合金，VIGON®N598 表面张力为 29.1mN/m ，H-62 黄铜不兼容，发行人产品表面张力及金属兼容性优于对标产品

注：对标企业产品数据主要来源于其产品说明书；若无法从公开渠道获取对标企业产品说明书，则根据发行人实验室测试数据进行比较，因测试方法、标准可能存在差异性，因此双方测试结果可能存在差异。

综合整体产品性能来看，国际巨头企业的产品实力仍具备领先优势，但在发行人擅长领域内，发行人多款核心代表性产品关键性能指标已达到甚至超越国际竞品水平，具备一定的技术优势，成功实现国产替代。

4、是否具备创新性和成长性

电子装联材料下游应用场景覆盖面广阔，当前国内高端市场长期由国际品牌主导。伴随全球地缘环境复杂化、中美贸易摩擦持续，产业链关键材料对外依赖带来的“卡脖子”风险持续凸显，全产业链自主可控成为国内产业端主要核心诉求，高端材料国产化替代进程加速推进，为国内具备技术实力的电子装联材料企业带来重大发展窗口期。

发行人依托关键原料设计合成技术、配方设计及生产工艺控制技术、特种工艺设备设计技术、产品检测及验证技术等核心技术，成功在有机硅胶、锡膏、清洗剂、自动化设备等部分产品建立技术优势，产品性能达到国内领先水平，多款

核心产品性能已达到甚至超越国际竞品水平。

发行人产品创新始终锚定行业发展趋势与下游客户实际需求，研发路径主要分为三类：一是基于客户现有需求，对存量产品定向迭代优化；二是紧跟行业新兴赛道、全新应用场景，开发适配性新产品；三是通过与下游主要客户的战略合作，针对客户的定制化前瞻性产品需求，配合客户产品研发进度，开发专属定制化创新性产品。以客户需求为核心的研发模式，保障发行人创新方向与行业发展方向、终端产品需求高度匹配。

综上，发行人产品具备创新性和成长性。

二、中介机构核查情况

请保荐人简要概括核查过程，并发表明确核查意见。

（一）核查情况

1、访谈发行人研发负责人、销售负责人，了解发行人相关产品在 AI 服务器和半导体封装领域的研发及商业化进展。

2、访谈发行人销售负责人，了解发行人与主要客户从配套开发至获取订单的完整业务流程，查阅发行人与主要客户的供应商系统、邮件往来、研发项目资料、领样送样记录、量产订单等，复核业务流程。

3、访谈发行人销售负责人，了解发行人下游主要厂商准入标准。查阅发行人与主要厂商签订的合同或发展合作协议等文件，确认供应商选择标准。

4、通过实地走访下游客户，了解发行人对客户同类产品供应份额。

5、访谈发行人研发负责人，了解发行人产品技术先进性体现，了解与国际厂商技术水平比较情况，了解与国内厂商技术体系、技术应用的差异情况。

6、获取国际厂商主要销售产品的产品说明书，获取发行人产品的实验室检测报告，对比相关产品性能指标。

（二）核查意见

经核查，保荐人认为：

1、报告期内，发行人在服务器、半导体领域销售收入实现较好增长；发行人在 AI 服务器、半导体封装两大先进应用领域延伸的进展情况良好，持续推进电子装联材料和自动化设备的研发、验证与批量交付。

2、报告期内，发行人与主要客户合作关系稳定，销售情况良好，不存在对主要客户供应份额或产品竞争力明显下降的情形；发行人供应份额下降、大客户流失的风险较小。

3、发行人主要产品在国内市场份额保持较为稳定或稳中有升；发行人核心产品的技术含量在于掌握了关键原材料的自主设计合成能力，并据此实现产品配方与性能的精准调控；发行人产品与竞争对手不存在明显技术差距；发行人产品具备创新性和成长性。

（本页无正文，为东莞优邦材料科技股份有限公司《关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函的回复》之签字盖章页）

发行人董事长：



郑建中

东莞优邦材料科技股份有限公司

2026 年 7 月 20 日

发行人法定代表人声明

本人已认真阅读《关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函的回复》全部内容，确认回复的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

发行人法定代表人：

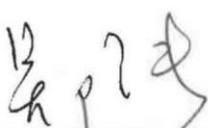

郑建中

东莞优邦材料科技股份有限公司

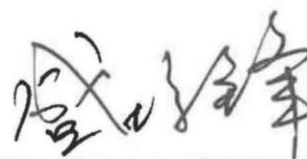
2026 年 7 月 20 日

（本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函的回复》之签字盖章页）

保荐代表人：



吴隆泰



盛培锋

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026 年 7 月 20 日

保荐人法定代表人声明

本人已认真阅读《关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函的回复》的全部内容，了解回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，审核问询函回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人法定代表人：


王明希

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026 年 7 月 20 日

